

证券代码：002156

证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国诚投资咨询：相健、胡均师、张文骏、江玉娇
时间	2023年2月2日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况</p> <p>通富微电主要从事集成电路封装测试业务，公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。</p> <p>公司抓住行业发展机遇，坚持发展主业的指导方针，注重质量，加快发展，继续做大做强。公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85% 股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地；2021 年，公司新增第七个封测基地——通富通科，位于南通市北高新区；2022 年上半年，通富通科一期约 2 万平米的改造厂房投入使用，二期约 3.4 万平米的厂房机电安装改造完成并顺利投产，创造了新的“通富速度”，为配合国家实现自主可控的存储器产品生产，做好厂房建设准备；2022 年 6 月 14 日，通富超威槟城启动新厂房建设仪式，新厂房占</p>

地约 85 亩，预计 2023 年竣工投入使用。目前，公司在南通拥有 3 个生产基地，同时，在苏州、槟城、合肥、厦门也积极进行了生产布局，产能方面已形成多点开花的局面。先进封装产能的大幅提升，为公司带来更为明显的规模优势。

财务数据方面，公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年分别实现营收 72.23 亿元、82.67 亿元、107.69 亿元和 158.12 亿元，2018 年至 2021 年公司营收平均复合增长率 29.85%。公司 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的归母净利润分别为 1.27 亿元、0.19 亿元、3.38 亿元和 9.57 亿元。公司 2022 年前三季度实现营收 153.19 亿元，实现归母净利润 4.77 亿元。受汇率波动影响，公司 2022 年前三季度产生“财务费用-汇兑损失”3.62 亿元(税前)，减少归母净利润 2.78 亿元(税后)，如剔除该非经营性因素的影响，公司 2022 年前三季度归母净利润应该为 7.55 亿元，同比增加 7.4%。

二、行业情况

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来，国家相继出台了若干产业政策，大力支持集成电路产业发展。

根据 IC Insights 2022 年 10 月份半导体行业最新数据显示，2022 年的全球功率半导体的销售额预计将同比增长 11%，达到 245 亿美元，实现连续第六年的增长，达到创纪录的历史最高水平。中国半导体行业协会发布，2021 年中国集成电路产业销售收入额首次突破万亿大关，达到 10,458.30 亿元，同比增长 18.2%；基于中国半导体产业在多领域实现突破，中国半导体行业协会预计 2022 年产业规模将增至 11,839 亿元。

我们将密切关注集成电路产业 2023 年的发展动向，抓住政策、市场、国际大客户等要素，稳扎稳打，进一步

将公司做强做大。

三、公司发展优势

半导体行业具有导入周期长且准入门槛高的特点，在通过客户验证形成合作后，业务稳定性较强且客户粘性较大，通富微电经过多年积累拥有优质的全球客户资源。目前，大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为通富微电的客户。

公司是全球产品覆盖面最广、技术最全面的封测龙头企业之一。公司面向未来高附加值产品及市场热点方向，在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G 等应用领域，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能，此外积极布局 Chiplet、2.5D/3D 等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

在技术方面，公司向来重视技术研发，研发投入占营收的比重在同行业中位居前列。在 7nm、5nm 的后摩尔时代，先进制程的良率问题让流片费用居高不下，Chiplet 技术可以在提升良率的同时进一步降低设计成本和风险。公司通过多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D 等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的 Chiplet 封装解决方案，并且已为 AMD 大规模量产 Chiplet 产品。FC 产品方面，已完成 5nm 制程的 FC 技术产品认证，同时多芯片 MCM 技术方面已确保 9 颗芯片的 MCM 封装技术能力，并推进 13 颗芯片的 MCM 研发；在超大尺寸 FCBGA-MCM 高散热技术方面，具备了 Indium TIM 等行业前沿材料的稳定量产能力，并成功完成了新型散热片的开发，继续保持公司在 FCBGA 封装技术方面的行业领先地位。公司先进封装项目荣获“国家科学技术进步一等奖”，该项目突破了高密度高可靠电子封装技术的瓶颈制约，为我国集成电路先进封装技术高端化发展发挥了支撑引领作用。

四、募投项目情况

	<p>公司已完成 2021 年度非公开发行股票事宜，共发行股票 184,199,721 股，募集资金总额约 26.93 亿元，用于募投项目建设、补充流动资金及偿还银行贷款。三个生产型募投项目分别为高性能计算产品封装测试产业化项目、微控制器（MCU）产品封装测试项目、功率器件产品封装测试项目。募投项目均围绕公司主营业务展开，产能释放后公司能够更好的抓住市场发展机遇，满足客户需求，规模优势更加突出，覆盖全面的产品布局与强大的规模化生产能力相得益彰，预计公司的市场竞争力将进一步提升。募投项目的详细情况，可以关注公司后续披露的相关公告。</p>
附件清单(如有)	—
日期	2023 年 2 月 2 日